公司代码：688120　　公司简称：华海清科

华海清科股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险，审慎作出投资决定。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 723,746,551.15 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 1,320,574,036.04 元，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每 10 股派发现金红利 5.50 元(含税)，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.90 股。

以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 158,933,383 股测算，共计拟派发现金红利 87,413,360.65 元(含税)，占 2023 年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为 12.08%；共计转增 77,877,358 股，转增后公司总股本增加至 236,810,741 股(具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准)。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所创板	华海清科	688120	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王同庆	王旭
办公地址	天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号	天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号
电话	022-59781962	022-59781962
电子信箱	ir@hwatsing.com	ir@hwatsing.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备供应商，主要产品包括 CMP 设备、减薄设备、划切设备、湿法设备、晶圆再生、关键耗材与维保服务等。

公司自成立以来始终坚持自主创新的发展路线，在纳米级抛光、纳米精度膜厚在线检测、纳米颗粒超洁净清洗、大数据分析及智能化控制等关键技术层面取得了有效突破和系统布局，开发出了 Universal 系列 CMP 设备、Versatile 系列减薄设备和划切设备、HSDS/HCDS 系列供液系统、膜厚测量设备，以及晶圆再生、关键耗材与维保服务等技术服务，初步实现了“装备+服务”的平台化战略布局。公司主要产品及服务已广泛应用于集成电路、先进封装、大硅片、第三代半导体、MEMS、MicroLED 等制造工艺，具体如下：

1、CMP 设备

类别/型号	图示	产品特征/应用领域
Universal 1000		具有四个 12 英寸抛光工位，满足多种抛光工艺模块设计，并优化清洗技术模块，具有更好的晶圆平坦度效果，控制能力精度高，满足先进制程需求，实现制造高良率。
Universal 300		具有两个 12 英寸抛光工位和四个清洗单元，可满足不同抛光工艺模块，可兼容多种耗材，具有高稳定性、高良率、先进制程等优势，实现制造高良率。
Universal 300Dual		具有四个 12 英寸抛光工位和双单晶清洗单元，可满足客户多工艺需求，实现集成电路、先进封装、大硅片等制造工艺。
Universal 200X		具有四个 12 英寸抛光工位和双单晶清洗单元，配备了区域抛光头，可满足客户多种应用需求，具有高稳定性、先进制程等优势，实现制造高良率。
Universal 200T		采用 Universal-200X 机型设计，配置 12 英寸抛光工位，具有高稳定性、先进制程、大硅片等优势，实现制造高良率。
Universal 300Ext		具有四个 8 英寸抛光工位和单晶清洗单元，可满足客户多工艺需求，提供多种耗材选择，具有高稳定性、先进制程、大硅片等优势，实现制造高良率。
Universal 300Ext		采用 Universal-300Ext 机型设计，配置 8 英寸抛光工位，具有高稳定性、先进制程、大硅片等优势，实现制造高良率。

2、减薄设备

类别/型号	图示	产品特征/应用领域
Versatile GP300		采用精密机械结构、随动压力控制等关键技术，具有较高的加工效率、高稳定性、高可靠性、先进制程等优势，实现制造高良率。
Versatile GM300		采用行星轮机械结构、双面同时研磨工艺、双面抛光工艺、在线测厚技术、自动上片技术等关键技术，具有高稳定性、高效率、先进制程等优势，实现制造高良率。

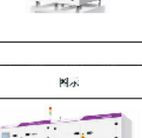
3、划切设备

类别/型号	图示	产品特征/应用领域
Versatile DP300		具有划切、检测、清洗及量测模块，配置自动对准系统、高精度主轴系统、金刚石刀具、自动换刀及高速修整等关键技术，具有高稳定性、先进制程等优势，实现制造高良率。

4、清洗设备

类别/型号	图示	产品特征/应用领域
HCDS 系列		主要应用于 12 英寸晶圆清洗工艺，具有兼容酸碱、有机溶剂、纯水、氮气等多种工艺模块，可满足客户多种工艺需求，具有高稳定性、先进制程等优势，实现制造高良率。
HSDS 系列		应用于 12 英寸晶圆清洗工艺，具有兼容酸碱、有机溶剂、纯水、氮气等多种工艺模块，可满足客户多种工艺需求，具有高稳定性、先进制程等优势，实现制造高良率。
HC-F3400		主要应用于 12 英寸晶圆清洗工艺，具有兼容酸碱、有机溶剂、纯水、氮气等多种工艺模块，可满足客户多种工艺需求，具有高稳定性、先进制程等优势，实现制造高良率。

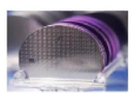
5、供液系统

类别/型号	图示	产品特征/应用领域
HDS		为晶圆清洗设备提供稳定、可靠的供液系统，满足客户多种工艺需求，具有高稳定性、高效率、先进制程等优势，实现制造高良率。
HCDS		为晶圆清洗设备提供稳定、可靠的供液系统，主要应用于 12 英寸晶圆清洗工艺，具有高稳定性、先进制程等优势，实现制造高良率。

6、膜厚测量设备

类别/型号	图示	产品特征/应用领域
Vision 300		具有精度高、速度快、稳定性强、操作简单、兼容性强、维护成本低等优势，可满足客户多种工艺需求，实现制造高良率。

7、晶圆再生

类别/型号	图示	产品特征/应用领域
晶圆再生		晶圆再生是将废弃晶圆经过抛光、清洗、检测等工序处理后，达到可再次投入生产线使用的状态，实现资源循环利用，降低成本、减少废弃物对环境的影响。公司为客户提供先进的工艺服务和高性价比的再生晶圆。

8、关键耗材与维保服务

类别/型号	图示	产品特征/应用领域
关键耗材与维保服务		关键耗材与维保服务主要是为客户在 CMP 设备或其他设备关键耗材选择、应用、维护、更换、优化等方面提供专业服务，关键耗材主要包括抛光垫、抛光液、抛光头、修整器、气膜囊、保护膜等，维保服务主要包括为客户提供设备维修、维护、升级等。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务，通过向下游集成电路制造商及科研院所等客户销售 CMP、减薄、划切、清洗等半导体设备，并提供关键耗材与维保、升级等技术服务和晶圆再生业务。报告期内，公司主营业务收入来源于半导体设备产品的销售，其他收入来源于关键耗材与维保、晶圆再生等技术服务。

2、研发模式

公司主要采取自主研发模式，取得了 CMP 设备、减薄设备、划切设备、清洗设备、膜厚测量设备等关键核心技术领域的重要成果。集成电路装备研发难度极高，按照国际行业惯用研发模式，公司的产品研发及商品化流程主要包括规划和概念阶段、设计阶段、开发实现阶段(Alpha 和 Beta)、验证确认阶段、量产及生命周期维护阶段。

3、采购模式

公司采购的主要原材料包括机械标准件类、机械加工类、气体/液体控制类、电气类和机电一体类等，其中机械加工类是供应商依据公司提供的图纸自行采购原材料并完成定制加工的零部件。其他常规标准零部件，公司面向市场进行独立采购。为保证公司产品的质量和性能，公司制定了严格的供应商选择和审核制度。公司会根据主生产计划、物料 BOM 清单和零部件的库存量，动态计算和更新零部件的采购计划，并按照采购计划在《合格供应商名录》中选择供方并进行采购。采购物资送达后，质量部进行到货检验，检验合格后由库房部办理入库手续，完成采购。

4、生产模式

公司产品均为根据客户的差异化需求，进行定制化设计及生产制造，主要采用以销定产的生产模式，实行订单式生产和库存式生产相结合的生产管理方式。基于公司设备采用模块化设计的优势，公司在客户有较明确采购预期、形成公司的销售预测单时就可以开始安排销售机台的模块库存式生产，通常先预生产一部分通用模块；等待获得正式订单后再开始订单式生产，根据确定的参数配置需求设计差异模块，生产剩余的通用模块(如有)和定制化方案中的差异模块并完成总装、测试。

5、销售模式

公司通过直销模式销售产品，与潜在客户商务谈判或通过招投标等方式获取订单。公司设有销售部负责市场开发、产品的销售，同时客户服务部的服务工程师在客户所在地驻场工作，负责公司产品的安装、调试、保修、维修、技术咨询。同时，公司也从事 CMP 等设备有关的耗材、配件销售以及相关技术服务，对于客户的设备耗材、备件以及维保、工艺测试、设备升级、晶圆再生等服务需求，公司在与之签订相关合同或订单后，协调公司有关部门完成相关发货、安装、测试等。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》，公司属于专用设备制造业(行业代码：C35)。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司属于专用设备制造业下的半导体器件专用设备制造(行业代码：C3562)。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》，公司属于“1.新一代信息技术产业”中“1.2.1 新型电子元器件及设备制造-3562* 半导体器件专用设备制造”。

随着物联网、大数据、云计算、人工智能、新能源、医疗电子等新兴应用领域迅速崛起，对半导体芯片的需求与日俱增，近年来全球半导体芯片领域持续扩大投资规模，带动了半导体器件专用设备制造行业快速发展。根据国际半导体产业协会(SEMI)统计，半导体制造设备全球总销售额 2023 年达到 1,063 亿美元，预计 2025 年的销售额预计将达到 1,240 亿美元的新高。

半导体器件专用设备制造在半导体行业产业链中占据重要的地位。半导体专用设备的技术复杂，客户对设备的技术参数、运行的稳定性有苛刻的要求。集成电路制造工艺的技术进步，反过来也会推动半导体专用设备企业不断追求技术革新。同时，集成电路行业的技术更新迭代也带来对于设备投资的持续性需求，而半导体专用设备的技术提升，也推动了集成电路行业的持续快速发展。半导体器件专用设备制造行业还具有技术含量高、制造难度大、设备价值高和行业门槛高等特点，被公认为工业界精密制造最高水平的代表之一。

半导体器件专用设备制造行业涉及微电子、电气、机械、材料、化学工程、流体力学、自动化、图像识别、通讯、软件系统等多学科、多领域知识，综合运用及动态密封技术、超洁净室技术、微粒及污染分析技术等多种尖端制造技术，具有较高的技术壁垒、市场壁垒和客户壁垒。以美国应用材料、荷兰阿斯麦、美国泛林、日本东京电子、美国科磊等为代表的国际半导体设备企业起步较早，经过多年发展，凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的优势，占据了全球和中国大陆地区半导体设备市场的主要份额。随着近年来全球半导体产业格局和市场环境的不断变化，半导体设备作为半导体制造行业的基石，其关键技术和产品的自主可控尤为重要，也给我国本土半导体设备制造商带来挑战和机遇。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

CMP 设备全球市场处于高度垄断状态，主要由美国应用材料和日本荏原两家设备制造商占据绝大部分的市场份额，且目前所有先进制程工艺的大生产线上应用的 CMP 设备均为这两家国际巨头提供。公司作为拥有自主知识产权的国内 12 英寸 CMP 设备厂商，凭借自身的技术与产品实力在国内 CMP 设备领域的市占率稳步提升，已基本覆盖国内 12 英寸先进集成电路大生产线，处于国内领先地位。综合考虑国内外市场差距及行业发展需求，公司发展空间大、前景可观，将迎来更大发展机遇。

近年来，集成电路向高集成化、高密度化和高性能化方向持续突破，同时随着 Chiplet 模式逐步成为摩尔定律趋缓下的半导体工艺发展方向之一，晶圆背面减薄技术在集成电路制造过程中的重要性愈发显著，而国内 IC 制造厂商所需的高精密减薄设备严重依赖进口，这将影响到供应链安全。国外晶圆超精密减薄加工起步较早，以日本 DISCO 公司为代表的海外减薄设备供应商具备先进技术，基本垄断全球减薄市场；国内厂商在晶圆减薄设备与工艺开发方面起步较晚，整体技术积累与国外有一定差距。公司于 2020 年独立承担减薄相关的国家级重大专项课题，2022 年实现关键突破，在技术层面已经可以对标国际友商的高端机型，同时减薄抛光一体机和转付封装领域的减薄机型均已取得重大进展。公司自主研发的 12 英寸超精密晶圆减薄机(Versatile-GP300)更是荣获中国 IC 风云榜年度优秀创新产品奖，在减薄市场发展潜力巨大。公司 2023 年首台 12 英寸单片终端清洗机 HSC-F3400 机台出机发往国内大硅片龙头企业，是在湿法设备系列产品中推出的又一项重要成果。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

在多层布线的立体结构集成电路中，化学机械抛光(CMP)技术依靠其优秀的全局平坦化能力、广泛的适用性以及低成本特点，逐渐成为晶圆制造和加工过程中的主流平坦化技术。随着集成电路技术的微缩化发展，芯片集成度增加，CMP 工艺在集成电路生产流程中的应用次数逐步增加。同时，先进的集成电路工艺对 CMP 设备的平坦化效果、控制精度、系统集成度和后清洗技术也提出了更高的要求。未来 CMP 设备将向着抛光头分区精细化、工艺控制智能化、清洗单元多能量组合化、预防性维护精益化的方向发展。CMP 设备的重要性和在产业链条中的投资占比将会逐步增加，发展空间持续扩张。公司作为国内领先的 CMP 设备供应商，随着工艺水平的不断提高，产品已逐步在国内多家一线大厂实现批量应用。未来随着机台保有量的增加、技术升级及平台化发展，公司在前道制造设备及相关耗材市场中的份额也将进一步提高。

先进封装、化合物半导体等领域有望随着人工智能、智能汽车、物联网、5G 通信等技术的发展迎来快速崛起的机会。随着摩尔定律接近极限，系统级封装、扇出型封装、2.5D/3D IC 封装、Chiplet 等先进封装技术可以同时实现降低功耗、提高性能、减小体积等关键目标。在高频、大功率等应用场景的驱动下，以 SiC、GaN 等为代表的化合物半导体的市场也将迎来前所未有的发展空间。随着先进封装和化合物半导体市场前景的明朗，预计减薄设备的需求也会逐步拉升。公司将继续把握市场机遇，在新领域实现突破。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	9,117,359,632.14	7,826,758,909.40	16.49	3,028,106,042.87
归属于上市公司股东的净资产	5,517,735,976.37	4,790,865,019.64	15.17	808,212,455.19
营业收入	2,507,991,057.37	1,648,838,308.18	52.11	804,880,460.70
归属于上市公司股东的净利润	723,746,551.15	501,601,016.84	44.29	198,276,664.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	608,121,136.27	379,953,807.61	60.05	113,975,999.06
经营活动产生的现金流量净额	652,931,193.42	25,102,682.25	2,501.04	389,805,247.69
加权平均净资产收益率(%)	14.11	16.23	减少 2.12 个百分点	27.98
基本每股收益(元／股)	4.55	3.52	29.26	1.66
稀释每股收益(元／股)	4.55	3.52	29.26	1.66
研发投入占营业收入的比例(%)	12.12	13.14	减少 1.02 个百分点	14.82

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	616,162,771.86	618,262,157.21	605,848,285.42	667,717,842.88
归属于上市公司股东的净利润	193,865,558.18	180,231,721.99	189,831,966.39	159,817,304.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	167,096,441.18	140,361,834.46	151,782,666.31	148,880,194.32
经营活动产生的现金流量净额	71,058,817.64	197,443,997.85	102,687,711.63	281,740,666.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					7,893			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					7,889			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0			
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0			
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0			
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0			
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
清控创业投资有限公司	14,732,946	44,800,183	28.19	44,800,183	44,800,183	无	0	国有法人
清津厚德(天津)科技合伙企业(有限合伙)	2,100,743	10,290,689	6.47	0	0	无	0	境内非国有法人
路新春	3,110,399	9,458,153	5.95	0	0	无	0	自然人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	6,953,092	6,953,092	4.37	0	0	无	0	境内非国有法人
天津科海投资发展有限公司	-619,348	5,323,412	3.35	0	0	无	0	国有法人
雒建斌	1,024,976	4,903,774	3.09	0	0	无	0	自然人
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	-1,394,125	3,605,875	2.27	0	0	无	0	境内非国有法人
招商证券资管-失控-招商资管臻享价值 2023031 号单一资产管理计划	2,517,760	2,517,760	1.58	0	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	2,262,657	2,262,657	1.42	0	0	无	0	境内非国有法人
清津立德(天津)科技合伙企业(有限合伙)	598,974	2,119,347	1.33	0	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明				清津厚德和清津立德为一致行动人，公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用				

存托凭证持有人情况

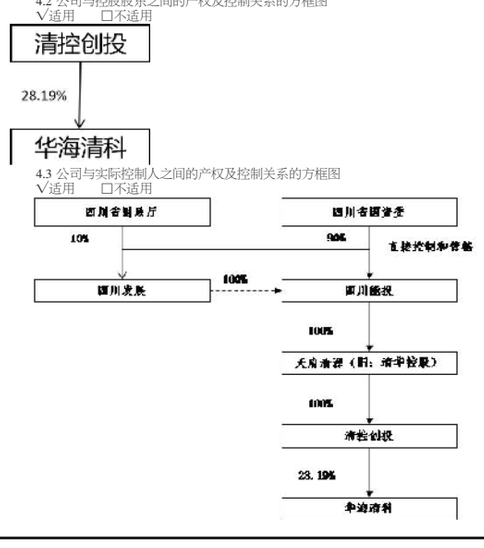
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

参考第三节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688120　　证券简称：华海清科　　公告编号：2024-024

华海清科股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华海清科股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式送达全体董事，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由公司董事长路新春先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二)审议并通过了《关于公司<2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》

同意公司《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(三)审议并通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

同意公司《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

(四)审议并通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

同意公司《2023 年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

(五)审议并通过了《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司独立董事在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。

公司独立董事金玉丰、李全和管荣齐向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上做述职报告。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(六)审议并通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

同意公司《2023 年度财务决算报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

(七)审议并通过了《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元(含税)，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.90 股。

以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 158,933,383 股测算，共计拟派发现金红利 87,413,360.65 元(含税)，占 2023 年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为 12.08%；共计转增 77,877,358 股，转增后公司总股本增加至 236,810,741 股(具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(八)审议并通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会对 2023 年度募集资金投资项目的进展情况进行了核查，对募集资金的存放与实际使用情况出具了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(九)审议并通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

同意《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票 4 票，其中赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十)审议并通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及全资子公司向银行申请总额不超过人民币 18 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于项目借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等，利率不高于 LPR 基准利率，贷款期限不超过 5 年，具体授信业务种类、额度和期限，以银行最终核定为准。本次授信的有效期自本议案审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内授信额度可循环使用。为提高效率，授权公司法定代表人在经批准的融资额度内，为上述融资事项签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十一)审议并通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

同意公司在全资子公司华海清科(上海)半导体有限公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度合计不超过人民币 2 亿元，华海清科(上海)半导体有限公司以其相关资产为该担保事项提供反担保，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司、华海清科(上海)半导体有限公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。该担保额度有效期自本议案审议通过之日起 12 个月内有效，同意授权公司法定代表人在经批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十二)审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款大额存单等)，使用期限自本议案审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。同意授权管理层在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十三)审议并通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币 13 亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品或中国证监会认可的其他投资产品，使用期限自本议案审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。同意授权公司管理层，在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十四)审议并通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十五)审议并通过了《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

同意《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十六)审议并通过了《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》。

同意《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案涉及的关联董事金玉丰、李全和管荣齐回避表决。

表决结果：有效票 6 票，其中赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十七)审议并通过了《关于<立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度履职情况评估报告>的议案》

同意《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十八)审议并通过了《关于<董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告>的议案》

同意《董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告》。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十九)审议并通过了《关于<2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》

同意《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二十)审议并通过了《关于<未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划>的议案》

同意《未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二十一)审议《关于确认公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度